



半導体パッケージ及び材料の技術マーケティング（東京・大阪・名古屋）【PID 電子材料事業部】

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。商品企画・開発（マーケティング...）

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

パナソニックインダストリー株式会社

Job ID

1521091

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年次有給休暇：年間25日付与（2022年度平均取得日数19.4日）※初年度のみ...

Refreshed

February 6th, 2025 17:12

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2279176】

●部のミッション

変化する世界に対し、マテリアルソリューションを通じて人々により良い暮らしと夢ある未来を提供

お客様と価値を共創して世の中に貢献していくことをスローガンに掲げている電子材料事業部、新たな価値の創出と技術実証、技術のシンカ（進/新/深）と融合で、事業成長を実現する商品に貢献することを目指すべき姿としているセンターの元、事業成長をもたらす事業アイデアを継続的に創出し実証することを部のミッションとしています。

●課のミッション

半導体パッケージ技術のマーケティングと材料ロードマップの策定

進化する半導体パッケージ技術の動向を調査し、その進化の先に必要とされる材料のロードマップを策定、開発部門と連携の上顧客へ訴求、市場投入して頂きます。

●担当業務と役割

電子材料の新商品企画及び技術開発を牽引し、市場投入のために関連部門と連携のうえ、総合的な戦略を立案・顧客（主にグローバル半導体メーカー）開発と折衝を行います。

- ・材料レイヤーよりも上位の基板、実装プロセスなどの知見を用いた、顧客開発と材料開発、技術マーケティング活動
- ・顧客ニーズやトレンド分析に基づき、新商品のターゲットスペックや商品戦略策定
- ・開発・技術部門との連携による商品具現化、顧客との折衝、開発・販売戦略をグローバルに展開

●具体的な仕事内容

・将来の有線系半導体デバイス、無線系半導体デバイスの進化・必要要件を調査し、そのパッケージ技術進化予測をもって材料のテーマ化、開発連携の上顧客折衝頂きます。

・入社後の力量を見極めたうえで、担当頂くアプリケーション分野を決定し、その分野の半導体デバイスのパッケージ形態を技術マーケティング、顧客との直接折衝を担当します。FAE業務も含まれます。

●この仕事を通じて得られること

今後も進化が止まらない半導体パッケージ技術分野において、最先端の半導体技術を手掛けるグローバル企業と、ビジネスを通じてコネクスト、開発できます。

また、電子材料レイヤー視点から、地域、業界、市場といった広い視野を持って戦略を立案するなど、マーケターとしての自己成長の機会を得られます。

●職場の雰囲気

・若手とベテラン、また男女メンバーが入り混じった職場ですが、年齢や役職に関係なくフラットに議論・相談を行える組織です。

・個人に与えられる裁量が大きく、目標達成に向けて様々なアプローチを取って頂く事が可能です。

・グローバルで連携するため、国内外とのミーティングが多く、テレワークを中心に業務を進め、必要に応じて出社するという業務スタイルです。

●キャリアパス

・半導体パッケージのマーケターとしてグローバルに自立

・本人の希望も踏まえ、海外拠点でのマーケティングおよび責任者としての赴任可能性

・力量を踏まえ、マーケティング上位職への登用も検討

Required Skills

【経験】

- ・半導体パッケージの開発経験必須。（有機サブストレート基板開発、実装技術開発など）
- ・半導体パッケージ市場/ICメーカーとの対話力。
- ・新市場開拓、新商品開発企画力。
- ・FAE（Field Application Engineering）、かつ商品認定活動。

【知識】

- ・サブストレート基板、およびそのプロセスを熟知。
- ・半導体パッケージ業界用語、サプライチェーン。

【語学】

- ・英語によるビジネスコミュニケーション。

Company Description

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売